

次世代リソグラフィ技術研究会分科会

Next Generation Lithography Division.

次世代リソグラフィとは？

リソグラフィ技術は半導体の細分化を支える根幹です。最近では、細分化が20nmを切るところまで進み、非常に特殊化、高度化しています。最先端デバイスは、レイリーの式で表される光リソグラフィの解像限界を超えた微細領域に突入しており、パターンのピッチを2倍あるいはそれ以上にするマルチパターンニング技術が量産に使用されています。この光（液浸）リソグラフィとマルチパターンニングの組合せも、難易度やコストの面から限界に近付いており、本質的に解像力を向上させる EUV リソグラフィ（EUVL）、マルチビーム電子線リソグラフィ、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）、自己組織化リソグラフィ（DSA）の開発が精力的に進められており、EUVL は 1980 年代から研究開発が進められてきました。投影光学系、レジスト、マスクなどは着実に進歩しているが、光源の出力不足が最大の課題とされてきましたが、大きな進歩が認められます。EUVL では、欠陥を防止するためのペリクルが使えないことが実用化への懸念の一つでしたが、レジストの解像力、感度、ラフネスのトレードオフ問題や、低欠陥密度のマスク製作など、まだ課題は残っているが、ここ 1~2 年での量産適用を目指すデバイスメーカーもあり、開発速度が上がっている研究分野です。

次世代リソグラフィ技術研究会分科会

本分科会は16年1月に研究会から“分科会”へと変更となりました。より活発な活動が期待されています。

東京大学大学院工学系研究科
機械工学専攻

幹事長：石原直氏



分科会イベント情報

- (1) 研究例会
会員のみを対象とし、年数回開催しています。最新の研究成果や国際会議の報告と討論をしております。
- (2) NGL ワークショップ
会員以外も対象とし（公開）、年1回開催します。当面する重要な技術課題を主テーマに設定し、基調講演、技術講演、ポスター発表等により、広い視野に立った技術動向の把握と新しい方向性を見出すことを目的としています。

本特集編集内容（仮）

- ・幹事長へのインタビュー（活動方針や魅力など）
- ・分科会の活動内容（研究会・セミナー・スクールやイベント、国際会議など）
- ・若手研究者の紹介
- ・賛助会員企業の紹介 など

掲載号：応用物理9月号（予定）
（16年9月10日発行）

部数：23,000部（全会員）



誌面イメージ

掲載料金（税別）

	賛助会員（分科会・本会）	一般会員
記事4色 1/2頁	260,000円	280,000円
4色 1頁	260,000円	280,000円
2色 1頁	160,000円	180,000円
1色 1頁	135,000円	155,000円

申込締切日
7月30日（金）